GL11/GL21（铝基覆铜板）

特点

- 适用于手工焊接
- 良好的绝缘性
- 优异的尺寸稳定性
- 高性价比
- GL11 为表面阳极氧化铝基板
  GL21 为非表面阳极氧化铝基板

FEATURES

- Suitable for manual soldering
- Good Insulation
- Excellent Dimensional Stability
- Cost-effective
- GL11 Surface Anodic Oxidation Treatment CCL；GL21 Free Surface Anodic Oxidation Treatment CCL

应用领域

- LED 照明等领域

APPLICATIONS

- LED Lighting etc.

GENERAL PROPERTIES

Item	Test Condition	Unit	Specification	Actual Value
Thermal Conductivity	CPCA-4105-2010	W/m·K	λ＜1.0	0.6
Heat Resistance	CPCA-4105-2010	$K\cdot m^2/W$	$\leq 2.0\times10^{-4}$	1.8×10^{-4}
Thermal Stress	288℃ Solder Float	S	288℃≥60	80
Peel Strength	288℃/10s Float	LBS/IN	≥6	7
Dielectric Breakdown	AC	KV	≥2	3
Flammability	UL94	/	V-0	ACC

注 1: 上表中击穿电压，铝基覆铜板板按 CPCA 4105-2010 C.8 AC 条件下进行测试可满足要求.

2: 铝基 PCB 板击穿电压因受边缘线距的影响,飞弧、爬电现象会使测试电压偏低，因此建议在油浴状态下进行检测评估基板耐电压性能。

规　　格：

产品厚度：0.8mm；1.0mm；1.2mm；1.5 mm；1.6mm；2.0mm

铜箔规格：18μm；1oz；1.5oz；2oz；3oz；28μm

供应尺寸：1000x1200mm；1050x1250mm；特殊尺寸单独定制。